



**EV Group Announces Next Generation Resist Processing System Based on New 200mm Platform
– November 9, 2022**

EV Group, 새로운 200mm 플랫폼 기반 차세대 레지스트 처리 시스템 발표

- 2022-11-09

- 신윤오 기자, yoshin@elec4.co.kr

EVG@150, 모듈 용량 늘려 생산성 높이고 장비 풋프린트 축소

EV Group(이하 EVG)은 자사의 리소그래피 솔루션 포트폴리오에 속하는 차세대 200mm 제품으로서 EVG@150 자동화 레지스트 처리 시스템을 출시한다고 밝혔다.

새로운 디자인의 EVG150 플랫폼은 이전 세대 플랫폼과 비교해서 최대 80퍼센트까지 더 높은 생산성, 우수한 범용성, 50퍼센트 더 작은 풋프린트가 특징이다.



범용 플랫폼으로서 신뢰할 수 있는 고품질 코팅 및 현상 공정을 가능하게 하므로, 첨단 패키징, MEMS, RF, 3D 센싱, 전력 반도체, 포토닉스를 비롯한 다양한 디바이스 및 애플리케이션에 적용할 수 있다. 새로운 장비는 우수한 생산성과 유연성 및 반복성을 통해 대량 생산과 산업용 개발 양쪽 모두의 까다로운 요구를 충족한다.

11월 15일부터 18일까지 나흘간 독일 뮌헨의 메세 뮌헨에서 개최되는 세미콘 유로파(SEMICON Europa) 전시회에서 EVG 부스를 방문하면 EVG의 임직원들로부터 직접 차세대 EVG150 레지스트 처리 시스템에 관한 설명을 들을 수 있다(EVG 부스 번호: #C1211).

세계적인 EBS(electronic based system) 연구 센터인 실리콘 오스트리아 랩스(Silicon Austria Labs)는 차세대 EVG150 시스템의 첫 번째 고객이다.

실리콘 오스트리아 랩스의 마이크로시스템 연구 부문장인 모센 모리디(Mohssen Moridi) 박사는 “우리는 선도적인 제조회사들과 협력해서 인더스트리 4.0, 사물 인터넷(IoT), 자율 운전, 사이버-물리 시스템(CPS), 인공지능(AI), 스마트 시티, 스마트 에너지, 스마트 의료의 토대를 마련하는 기술들을 개발하고 있다”며, “EVG의 차세대 EVG150 레지스트 처리 시스템은 유연성이 뛰어난 EBS 혁신을 촉진하는 우리의 개발 고객들과 함께 새로운 공정과 제품의 대규모 구현을 위한 발판을 마련하는 데 도움이 된다”고 말했다.

EVG의 기업 테크놀로지 디렉터인 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 박사는 “레지스트와 패터닝 공정은 반도체 제조에 있어서 가장 반복적으로 사용되는 공정들이다. EVG는 리소그래피와 회전 및 분사 코팅 등의 공정 분야에서 다년간 쌓아온 전문성을 바탕으로 고객들의 극히 까다로운 요구를 충족하는 솔루션을 제공한다”고 밝히고 “차세대 EVG150 시스템은 이러한 경험을 토대로 탄생한 것으로서, 범용 플랫폼으로 새로운 차원의 생산성과 비용 상의 이점을 달성하도록 설계되었으며 전례 없이 뛰어난 유연성으로 다양한 애플리케이션의 레지스트 공정 요구를 충족한다”고 말했다.

<저작권자(c)스마트앤컴퍼니. 무단전재-재배포금지>

<https://www.elec4.co.kr/article/articleview.asp?idx=30792>